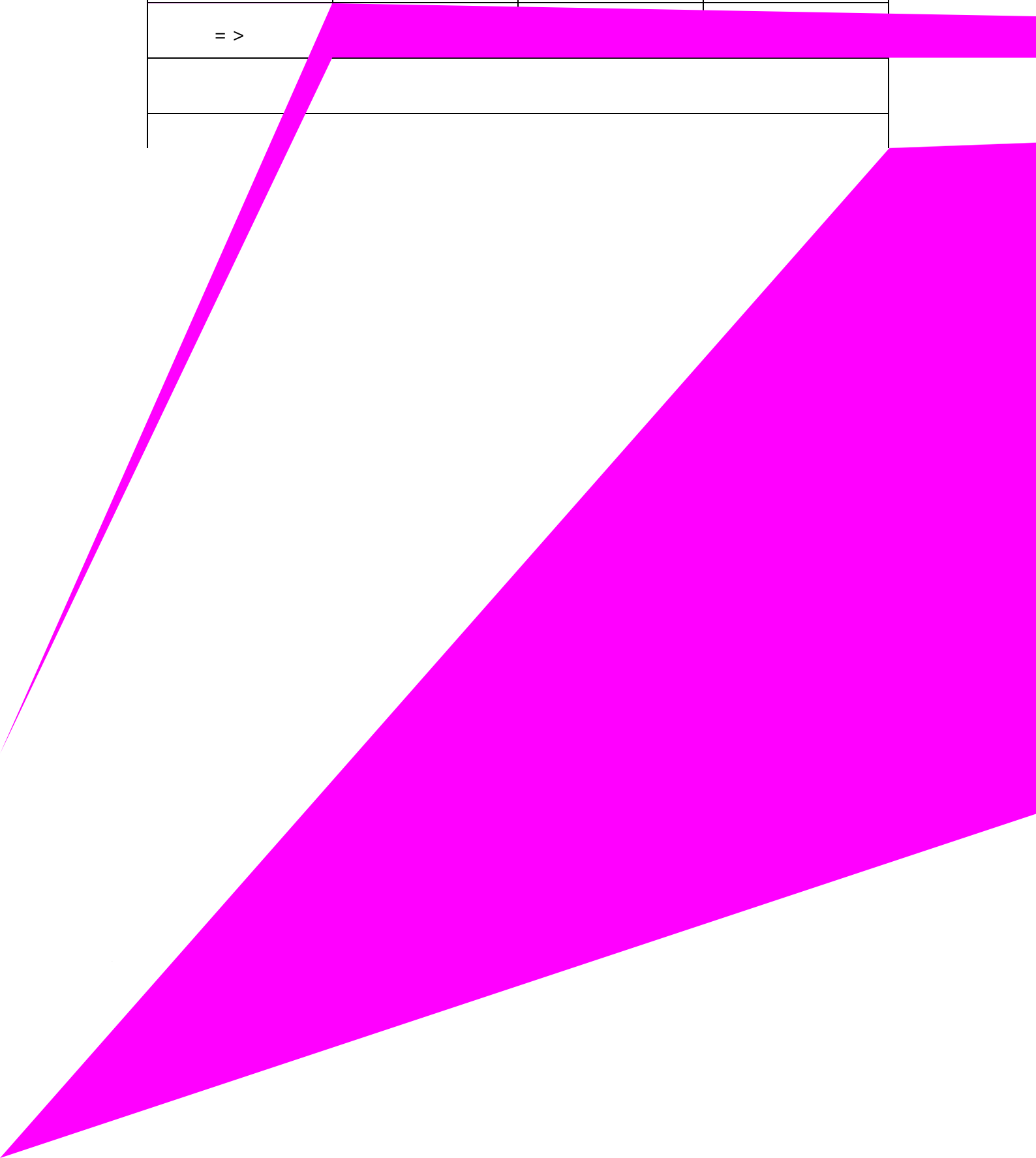





= >			



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）



发行人：华虹半导体有限公司

2023年7月18日


(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页)

联席保荐人（联席主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

2023 年



（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

联席保荐人（联席主承销商）：海通证券股份有限公司

2023年7月18日

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页)

华虹半导体有限公司



2023年7月18日

(此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页)

联席主承销商：中国国际金融股份有限公司







（此页无正文，为《华虹半导体有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告》之盖章页）

联席主承销商：国开证券股份有限公司

